

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2025/246150 A1

(43) 国际公布日
2025 年 12 月 4 日 (04.12.2025)

(51) 国际专利分类号:
H01L 23/498 (2006.01) **H05K 1/18** (2006.01)
H01L 23/528 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2024/126273

(22) 国际申请日: 2024 年 10 月 22 日 (22.10.2024)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202410675094.6 2024 年 5 月 27 日 (27.05.2024) CN

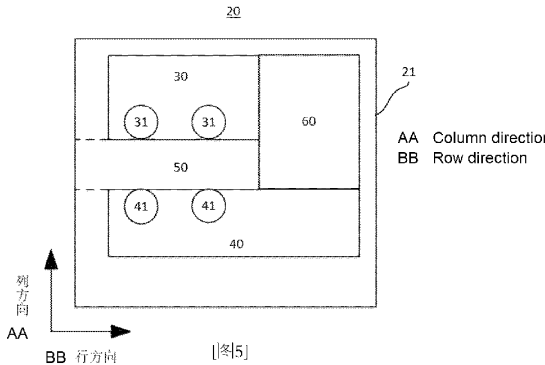
(71) 申请人: 长鑫科技集团股份有限公司 (CXMT CORPORATION) [CN/CN]; 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。

(72) 发明人: 石恒荣 (SHI, Hengrong); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。石宏龙 (SHI, Honglong); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。李瑞 (LI, Rui); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。程景伟 (CHENG, Jingwei); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。张兴 (ZHANG, Xing); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。刘群 (LIU, Qun); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 230601 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,

(54) Title: PACKAGING STRUCTURE, SEMICONDUCTOR STRUCTURE, AND ELECTRONIC DEVICE

(54) 发明名称: 封装结构、半导体结构及电子设备



(57) Abstract: A packaging structure, a semiconductor structure, and an electronic device. The packaging structure comprises: a substrate; a first pin array, which is arranged on the substrate and comprises a plurality of first data pins; and a second pin array, which is arranged on the substrate and comprises a plurality of second data pins. A blank area is provided between the first pin array and the second pin array, the blank area extends from the center of the substrate to the edge of the substrate, the end of the blank area is located on the outer side of the first pin array, at least one first data pin and/or at least one second data pin is adjacent to the blank area, and the minimum size of the blank area is larger than the diameter of the first data pin. The size of the packaging structure is small.

(57) 摘要: 一种封装结构、半导体结构和电子设备。该封装结构包括基底; 第一引脚阵列, 设置在基底上, 第一引脚阵列包括多个第一数据引脚。第二引脚阵列, 设置在基底上, 第二引脚阵列包括多个第二数据引脚。第一引脚阵列和第二引脚阵列之间设置有空白区域, 空白区域从所述基底的中心向所述基底的边缘延伸, 所述空白区域的端部位于所述第一引脚阵列的外侧, 至少一个所述第一数据引脚和/或至少一个所述第二数据引脚与所述空白区域相邻, 所述空白区域的最小尺寸大于所述第一数据引脚的直径。封装结构的尺寸小。

[见续页]

CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。